

Электроника **Dow Corning® TC-5622**  
Теплопроводящая паста

**ОСОБЕННОСТИ И  
ПРЕИМУЩЕСТВА**

- Состав, не содержащий растворителей
- Лёгкость применения
- Низкое температурной сопротивление
- Высокая теплопроводность
- Хорошая стабильность и надёжность

**СОСТАВ**

- Насыщенный полидиметилсилоксан

Серая, текучая, неотверждающаяся, теплопроводящая паста

**ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ**

- *Dow Corning®* TC-5622 Теплопроводящий компаунд предназначен для обеспечения эффективной передачи тепла для охлаждения электронных модулей, включая компьютерные МПУ и блоки питания.

**ТИПОВЫЕ СВОЙСТВА**

Авторы спецификаций: Данные значения не предназначены для использования при подготовке спецификаций. Перед написанием спецификаций данного продукта просим связаться с местным офисом продаж Dow Corning или глобальным офисом.

Свойство	Ед.изм.	Результат
Вязкость	сП	95 000
	Па-сек	95
Относительная плотность (неотвержд.)	-	2,5
Теплопроводность	Вт/мК	4,3
Термостойкость при 25 Н/см <sup>2</sup>	°С*см <sup>2</sup> /Вт	0,06
Толщина клеевого шва	дюймы	0,0008
	мм	0,02